

||BOND® Etch 20 Gel||BOND® Etch 35 Gel||BOND® Etch 35 Fluid

DE Gebrauchsanweisung

GB Instructions for use

FR Mode d'emploi

ES Instrucciones de uso

IT Istruzioni per l'uso

PT Instruções de uso

NL Gebruiksaanwijzing

SE Bruksanvisning

DK Brugervejledning

NO Bruksanvisning

FI Käyttöohjeet

GR Οδηγίες χρήσης

CZ Návod k použití

HU Használati utasítás

LV Lietošanas instrukcija

LT Naudojimo instrukcija

PL Instrukcja obsługi

	KULZER MITSUI CHEMICALS GROUP
	Manufacturer: Kulzer GmbH Leipziger Straße 2 63450 Hanau (Germany)
	Distributed in USA / Canada exclusively by: Kulzer, LLC 4315 South Lafayette Blvd. South Bend, IN 46614-2517 1-800-431-1785
	0197

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid

Produktbeschreibung

iBond® Etch Gel/Fluid sind Ätzmittel auf Basis von Orthophosphorsäure. Sie werden verwendet zum Ätzen von Zahnschmelz und der Konditionierung von Dentin im Rahmen der adhäsiven Füllungstherapie.

Zusammensetzung

iBond® Etch 20 Gel enthält 20 % Phosphorsäure
iBond® Etch 35 Gel/Fluid enthalten 35 % Phosphorsäure
ferner enthalten die Produkte Verdickungsmittel, Pigmente, Wasser

Indikationen

Schmelzätzung und Schmelz-/Dentin Ätzung im Rahmen der Total-Etch-Technik vor der adhäsiven Befestigung von:

• Komposit- und Komponer-Restaurationen • Laborgefertigten, indirekten Restaurationen (z.B. Inlays, Kronen, Brücken, Veneers) • Versiegelungen

Kontraindikationen

• Applikation auf pulpanahem Dentin (weniger als 1 mm) • Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen iBond® Etch

Nebenwirkungen

Allergien gegen das Produkt oder seine Bestandteile können im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden – Inhaltsstoffe sind im Verdachtsfall beim Hersteller zu erfragen.

Wechselwirkungen

Liner und Unterfüllungsmaterialien, wie z.B. Calciumhydroxid, können je nach Art und Zusammensetzung durch die Säure gelöst werden.

Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen

iBond® Etch 20 Gel enthält 20 % Phosphorsäure und ist reizend. iBond® Etch 35 Gel und Fluid 35 enthalten 35 % Phosphorsäure und können Verätzungen verursachen. Augenreizung möglich. Kontakt mit Gingiva, Haut, Augen oder Nachbarzähnen ist zu vermeiden. Bei Kontakt mit Mundschleimhaut gründlich mit viel Wasser ausspülen. Nach Verschlucken Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzt konsultieren. Bei Kontakt mit Haut gründlich mit Seife und Wasser spülen. Bei Augenkontakt gründlich mit viel Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Schutzkleidung tragen. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Mit iBond® Etch 35 Gel und iBond® Etch 35 Fluid verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid

Product description

iBond® Etch Gel and Fluid are etching agents based on orthophosphoric acid. They are used to etch enamel and condition dentine in the context of adhesive filling therapy.

Composition

iBond® Etch 20 Gel contains 20 % phosphoric acid
iBond® Etch 35 Gel/Fluid contain 35 % phosphoric acid
The products further contain Thickening agents, Pigments, Water

Indications

Enamel etching and enamel/dentine etching in the context of the total etch technique prior to the adhesive bonding of:

• Composite and compomer restorations • Laboratory-fabricated, indirect restorations (e.g. inlays, crowns, bridges, veneers) • Sealants

Contraindications

• Application to dentine close to the pulp (less than 1 mm) • Do not use in case of known hypersensitivity to iBond® Etch

Side effects

This product or one of its components may, in particular cases, cause allergic reactions. If suspected, information on the ingredients can be obtained from the manufacturer.

Interactions

Liner and base materials, such as calcium hydroxide, may be dissolved by the acid, depending on their type and composition.

Warnings/precautions

iBond® Etch 20 Gel contains 20 % phosphoric acid and is an irritant. iBond Etch 35 Gel and Fluid 35 contain 35 % phosphoric acid and can cause chemical burns. May irritate eyes. Avoid contact with gingiva, skin, eyes or neighbouring teeth. In case of contact with oral mucosa, rinse thoroughly with plenty of water. If swallowed, thoroughly rinse mouth with water and then drink plenty of water. Consult a physician. In case of contact with skin, thoroughly rinse with soap and water. In the event of contact with eyes, rinse thoroughly with water and seek medical advice. Wear suitable protective gloves. Avoid skin contact. Wear protective clothing. Wear safety glasses/face protection. Immediately remove clothing contaminated with iBond® Etch 35 Gel or iBond® Etch 35 Fluid.

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid

Description du produit

iBond® Etch Gel et Fluid sont des agents de mordantage à base d'acide orthophosphorique. Ils sont utilisés pour mordancer l'émail et conditionner la dentine dans le contexte d'un traitement d'obturation adhésif.

Composition

iBond® Etch 20 Gel contient 20% d'acide phosphorique. iBond® Etch 35 Gel/Fluid contient 35% d'acide phosphorique. Les produits contiennent également des agents épaississants, des pigments et de l'eau.

Indications

Mordantage de l'émail ou mordantage de la dentine dans le contexte de la technique de mordantage total avant le collage adhésif de:

• Restauration en composite et en compomère • Restauration indirectes, fabriquées au laboratoire (par ex. inlays, couronnes, bridges, facettes) • Scellement de sillons

Contre-indications

• Application sur de la dentine proche de la pulpe (moins de 1 mm) • Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à iBond® Etch

Effets secondaires

Ce produit ou l'un de ses composants peut dans certains cas provoquer des réactions allergiques. En cas de doutes, des informations plus précises à propos des ingrédients peuvent être obtenues auprès du fabricant.

Interactions

Les liners ou les matériaux de fond de cavité, tel que l'hydroxyde de calcium, peuvent être dissous par l'acide, selon leur type et leur composition.

Précautions

iBond® Etch 20 Gel contient 20% d'acide phosphorique et est un agent irritant. iBond Etch 35 Gel et Fluid contiennent 35 % d'acide phosphorique et peuvent provoquer des brûlures chimiques. Ils peuvent irriter les yeux. Éviter tout contact avec la gencive, la peau, les yeux et les dents adjacentes. En cas de contact avec la muqueuse buccale, rincer soigneusement avec beaucoup d'eau. En cas d'ingestion, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau, puis boire beaucoup d'eau. Consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, rincer soigneusement avec du savon et de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et soigneusement avec de l'eau et consulter un médecin. Porter des gants de protection adéquats. Éviter tout contact avec la peau. Porter des vêtements de protection. Porter des lunettes ou un masque de protection. Retirer immédiatement les vêtements contaminés par iBond® Etch 35 Gel ou iBond® Etch 35 Fluid.

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid

Descripción del producto

iBond® Etch Gel y Fluid son materiales de grabado compuestos de ácido ortofosfórico. Se utilizan para grabar el esmalte y acondicionar la dentina en los procedimientos de obturación adhesiva.

Composición

iBond® Etch 20 Gel contiene ácido fosfórico al 20%.
iBond® Etch Gel e iBond® Etch Fluid contienen ácido fosfórico al 35%.
Los productos contienen además espesantes, pigmentos y agua.

Indicaciones

Grabado del esmalte y del esmalte/dentina con la técnica de grabado total previa a la fijación adhesiva de:

• Restauraciones de composite y compómero • Restauraciones indirectas (p. ej., inlays, coronas, puentes, carillas) fabricadas en el laboratorio • Sellados

Contraindicaciones

• Aplicación en la dentina próxima a la pulpa (menos de 1 mm) • No debe utilizarse en caso de hipersensibilidad conocida a iBond® Etch

Efectos secundarios

En raras ocasiones, este producto o alguno de sus componentes pueden provocar reacciones alérgicas. En caso de sospecha, solicite al fabricante información acerca de los componentes.

Interacciones

Los materiales de revestimiento y de base, como el hidróxido de calcio, pueden disolverse con ácido en función de su tipo y composición.

Advertencias/precauciones

iBond® Etch 20 Gel contiene ácido fosfórico al 20 % y es irritante. iBond® Etch Gel e iBond® Etch Fluid contienen ácido fosfórico al 35 % y pueden provocar quemaduras químicas. Puede causar irritación ocular. Evite el contacto con las encías, la piel, los ojos o los dientes colindantes. En caso de contacto con la mucosa bucal, enjuague bien con agua abundante. En caso de ingestión, enjuague bien la boca con agua y luego beba grandes cantidades de agua. Consulte a un médico. En caso de contacto con la piel, enjuague bien con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con agua y solicite atención médica. Utilice guantes de protección adecuados. Evite el contacto con la piel. Utilice ropa protectora adecuada. Utilice gafas/máscara facial de seguridad. Quítese de inmediato la ropa contaminada con iBond® Etch 35 Gel o iBond® Etch 35 Fluid.

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid

Descrizione del prodotto

iBond® Etch Gel e Fluid sono agenti mordenzanti a base di acido ortofosforico. Vengono impiegati per mordenzare lo smalto e condizionare la dentina nell'ambito dell'odontoiatria restitutiva adesiva.

Composizione

iBond® Etch 20 Gel contiene acido fosforico al 20%. iBond® Etch 35 Gel/Fluid contiene acido fosforico al 35%. I prodotti contengono addensanti, pigmenti, acqua.

Indicazioni

Mordenzatura dello smalto e mordenzatura di smalto/dentina nell'ambito della tecnica "total etch" prima dell'applicazione adesiva di:

• Restauri in composito e in compomero • Restauri indiretti, prefabbricati in laboratorio (ad es. inlay, corone, ponti, faccette) • Sigillanti

Controindicazioni

• Applicazione sulla dentina in prossimità della polpa (distanza inferiore a 1 mm) • Non utilizzare in caso diipersensibilità nota verso iBond® Etch

Effetti collaterali

Questo prodotto o i suoi componenti possono causare reazioni allergiche in determinati casi. In caso di dubbio, rivolgersi al produttore per informazioni sugli ingredienti.

Interazioni

A seconda della tipologia e della composizione, i liners e le basi, ad esempio l'idrossido di calcio, possono sciogliersi a contatto con l'acido.

Avvertenze/precauzioni

iBond® Etch 20 Gel contiene acido fosforico al 20 % ed è irritante. iBond Etch 35 Gel e Fluid 35 contengono acido fosforico al 35 % e possono causare ustioni chimiche. Possono inoltre irritare gli occhi. Evitare il contatto con la gengiva, la cute, gli occhi o i denti adiacenti. In caso di contatto con la mucosa orale, sciacquare accuratamente con abbondante acqua.

In caso di ingestione, sciacquare accuratamente la bocca con acqua, poi bere abbondante acqua. Consultare un medico. In caso di contatto con la cute, sciacquare accuratamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente con acqua e consultare un medico. Indossare adeguati guanti protettivi. Evitare il contatto con la cute. Indossare indumenti protettivi. Indossare occhiali protettivi/mascherina per il viso. Togliere immediatamente eventuali indumenti contaminati con iBond® Etch 35 Gel o iBond® Etch 35 Fluid.

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid

Descrição do produto

iBond® Etch Gel e iBond® Etch Fluid são agentes de condicionamento constituídos à base de ácido ortofosfórico. A utilização destes produtos é indicada para o condicionamento de esmalte e dentina no processo de tratamento com restauração adesiva.

Composição

iBond® Etch 20 Gel contém 20% de ácido fosfórico. iBond® Etch 35 Gel/Fluid contém 35% de ácido fosfórico. Estes produtos contém ainda agentes espessantes, pigmentos e água.

Indicações

Condicionamento de esmalte e esmalte/dentina na técnica de condicionamento total (total etch) prévio à restauração adesiva de:

• Restaurações de resina composta e compómero • Restaurações indiretas realizadas em laboratório, (como inlays, coroas, próteses parciais e facetas) • Selantes

Contra-indicações

• Aplicação à dentina próxima da polpa (a menos de 1 mm) • Não usar em casos de pacientes com sensibilidade ao iBond® Etch

Efeitos secundários

Este produto ou um dos seus componentes podem, em casos específicos, provocar reações alérgicas. Em caso de suspeita de reação alérgica, é possível obter informações sobre a composição com o fabricante.

Interações

Materiais de forramento e base, como o hidróxido de cálcio, podem ser dissolvidos pelo ácido, dependendo do seu tipo e composição.

Avisos / precauções

iBond® Etch 20 Gel contém 20% de ácido fosfórico e é um irritante. iBond Etch 35 Gel e Fluid 35 contém 35% de ácido fosfórico e pode provocar queimaduras químicas. Pode irritar os olhos. Evite o contato com a gengiva, pele, olhos e os dentes adjacentes. Em caso de contato com a mucosa oral, lave cuidadosamente com água em abundância. Em caso de ingestão, lave cuidadosamente a boca com água em abundância e beba bastante água. Consulte um médico. Em caso de contato com a pele, lave cuidadosamente com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lave com água em abundância e consulte um médico. Use luvas de proteção adequadas. Evite o contato com a pele. Use roupas protetoras. Use óculos de segurança / proteção para o rosto. Remova imediatamente as roupas contaminadas com iBond® Etch 35 Gel ou iBond® Etch 35 Fluid.

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid

Produktbeskrivning

iBond® etsgel en etsvöestof som är etsmedletten på basis van fosforzour. Ze worden gebruikt om glazuur te etsen en het dentine te conditioneren bij de adhesieve vultherapie.

Samenstelling

iBond® Etch 20 Gel bevat 20% fosforzour. iBond® Etch 35 Gel/Fluid bevat 35% fosforzour.

De producten bevatten verder verdikkingsmiddelen, pigmenten en water

Indicates

Etsen van glazuur en etsen van glazuur/dentine bij toepassing van de Total Etch techniek vóór het met adhesief hechten van:

• Composiet- en compomeerrestauraties • In het laboratorium vervaardigde, indirecte restauraties (bv. inlays, kronen, bruggen en veneers) • Sealants

Contra-indicates

• Gebruik op dentine dichtbij de pulpa (minder dan 1 mm) • Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor iBond® Etch

Bijwerkingen

Dit product of een van de bestanddelen kan in bepaalde gevallen een allergische reactie veroorzaken. Bij vermoeden van een allergische reactie kan de fabrikant informatie verschaffen over de ingrediënten.

Interacties

Afhankelijk van het type en de samenstelling kunnen onderlaagmaterialen, zoals calciumhydroxide, door het zuur worden opgelost.

Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen

iBond® Etch 20 Gel bevat 20% fosforzour en is een irriterende stof. iBond® Etch 35 Gel en Fluid 35 bevatten 35% fosforzour en kunnen chemische brandwonden veroorzaken. Kan de ogen irriteren. Contact met het tandvlees, de huid, ogen of naburige gebitselementen vermijden. Bij contact met het mondslimvlies, grondig met veel water spoelen.

Bij doorslikken, grondig met water spoelen en vervolgens veel water drinken. Raadpleeg een arts. Bij contact met de huid, grondig met water en zeep spoelen. Bij contact met de ogen, mond met water spoelen en medisch advies inwinnen. Draag geschikte beschermende handschoenen. Vermijd contact met de huid. Draag beschermende kleding. Draag een veiligheidsbril /gezichtsbescherming. Kleding waarop iBond® Etch 35 Gel of iBond® Etch 35 Fluid is gemorst onmiddellijk verwijderen.

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid

Produktbeskrivning

iBond® Etch gel och vätska är etsningspreparat baserade på ortofosforsyra. De används för att etsa emalj och konditionera dentin i samband med adhesiv fyllningsterapi.

Innehåll

iBond® Etch 20 gel innehåller 20 % fosforsyra.
iBond® Etch 35 gel/vätska innehåller 35 % fosforsyra.

Produkterna innehåller dessutom förtjockningsmedel, pigment och vatten.

Indikationer

Emaljätning och emalj/dentinetätning i samband med "total etch"-metoden före adhesiv bonding av:

• Komposit- och komponentersätningar • Laboratorietillverkade, indirekta ersätningar (t.ex. inlays, kronor, broar och fasader) • Föreseglingar

Kontraindikationer

• Applisering på dentin nära pulpan (mindre än 1 mm) • Använd inte produkten om patienten är överkänslig mot iBond® Etch

Biverkningar

Denna produkt eller någon av dess komponenter kan i vissa fall orsaka allergiska reaktioner. Om det finns misstanke om detta kan information om innehållsämnen erhållas från tillverkaren.

Interaktioner

Liner och barmaterial, t.ex. calciumhydroxid, kan lösas upp av syran, beroende på deras typ och sammansättning.

Varningar/försiktighetsåtgärder

iBond® Etch 20 gel innehåller 20 % fosforsyra och är ett irretmedel. iBond Etch 35 gel och vätska 35 innehåller 35 % fosforsyra och kan orsaka kemiska brännskador. Kan irritera ögonen. Undvik kontakt med tandkött, hud, ögon och intilliggande länder. Vid kontakt med munslemhinnan, skölj noga med rikligt med vatten. Vid dörslikken, skölj munnen noga med vatten och drick sedan rikligt med vatten. Kontakta läkare. Vid hudkontakt, skölj noga med tvål och vatten. Vid ögonkontakt, skölj noga med vatten och uppsök läkare. Använd lämpliga skyddshandskar. Undvik hudkontakt. Använd skyddsglasögon/ansiktsskydd. Ta omedelbart av plagg som kontaminerats med iBond® Etch 35 gel eller iBond® Etch 35 vätska.

Anwendung

Zahn vor der Behandlung mit fluoridfreier Polierpaste sorgfältig reinigen. Die Verwendung von Kofferdam wird empfohlen.

1. Nach der Präparation komplett adhäsiver -Füllungstherapie Kavität abspülen und mit ölfreier Luft trocknen.

2. iBond® Etch beginnend an den angestrichen Schmelzarealen auf die gesamte Kavitättenoberfläche einschließlich Dentin aufbringen. Dabei darauf achten, dass der Schmelz mindestens 20 s, maximal 30 s getätzt und das Dentin mindestens 15 s und maximal 20 s konditioniert werden. Bei der Verwendung von iBond® Etch 35 Gel/Fluid sollte besonders Augenmerk auf die Einhaltung der Einwirkzeit auf dem Dentin gelegt werden. Um eine Überätzung zu vermeiden, kann hier auf 15 s verkürzt werden. Wenn gewünscht iBond® Etch nur auf den Schmelz aufbringen und maximal 30 s einwirken lassen. Nicht präparierten Schmelz, z.B. bei Fissurenversiegelungen mindestens 30 s, maximal 60 s anätzen. Bei fluoridiertem Schmelz kann es erforderlich sein, ebenfalls maximal 60 s anzusetzen.
Achtung: Bei tiefen Kavitäten wird vor dem Ätzen eine Abdeckung des pulpanahen Dentins mit einem Calciumhydroxid-Präparat und einer Unterfüllung (z.B. Glas-Ionomer-Zement) empfohlen.

3. iBond® Etch mit Wasserspray für 20 s vollständig abspraysen. Es dürfen keine Reste in der Kavität verbleiben.

4. Kavität mit ölfreier Luft trocknen (Dentin nicht austrocknen!). Die getätzte Schmelzoberfläche sollte ein kreidig weisses Aussehen haben. Bei Kontamination der Zahnoberfläche (z.B. Speichel), muss der Ätzwargen (maximal 10 s Einwirkzeit) wiederholt werden.

5. Weitere Versorgung mit Haftvermittler (z.B. iBond® Total Etch) und Composite (z.B. VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) gemäß Herstellerangaben.

Hinweise

iBond® Etch Gel kann mit Pinseln oder Kanülen, iBond® Etch Fluid mit Pinseln aufgetragen werden. Sowohl Pinsel als auch Kanülen sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt. Nach dem Applizieren des Gels Kolben entleeren. iBond® Etch Gel und iBond® Etch Fluid nach Gebrauch wieder mit entsprechendem Stopfen bzw. Verschlusskappe verschließen.

Nachdem Hinweise

Nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch durch Zahnärzte. Für Kinder unzugänglich aufbewahren

Lagerbedingungen

Unter 25°C (77°F) lagern. Nach Ablauf des Verfallsdatums sollte das Material nicht mehr verwendet werden. Bei Rückmeldungen zum Produkt bitte immer Chargenbezeichnung und Verfalldatum angeben. Verfalldatum 2 s und Chargenbezeichnung ☺. Siehe Hinweis auf Spritze/Verpackung. Nur vollständig entleerte Verpackungen zur Verwertung geben. Reste von Ätzflüssigkeit können stark verdünnt mit Wasser oder neutralisiert mit dem Abwasser entsorgt werden.
Stand: 2009-07

Application

Prior to treatment, carefully clean tooth with fluoride-free polishing paste. The use of a rubber dam is recommended.

1. After preparation, rinse the cavity in accordance with adhesive filling therapy and dry with oil-free air.

2. Starting from the bevelled enamel areas, apply iBond® Etch to the entire cavity surface, including the dentine. Ensure that the enamel is etched for at least 20 s and no more than 30 s, and that the dentine is conditioned for at least 15 s and no more than 20 s. When using iBond® Etch 35 Gel/Fluid, pay special attention to complying with the dwell time on the dentine. Reducing the time to 15 s in these areas is permissible to avoid overetching. If desired, only apply iBond® Etch to the enamel and let set for a maximum of 30 s. Etch unprepared enamel, e.g. in case of fissure sealing, for at least 30 s and no more than 60 s. In case of fluoridated enamel, etching for no more than 60 s may also be required.

Caution: In case of deep cavities, we recommend covering the dentine near the pulp with a calcium hydroxide preparation and a base (e.g. glass ionomer cement) prior to etching. 3. Use a water sprayer to completely rinse off iBond Etch for 20 s. The cavity must be completely free of any remnants.

4. Dry the cavity with oil-free air (do not dry out dentine!). The etched enamel surface should appear chalky white. In case of contamination of the tooth surface (e.g. with saliva), the etching must be repeated (for a maximum of 10 s dwell time).

iBond® Eтч 20 Gel, iBond® Eтч 35 Gel, iBond® Eтч 35 Fluid

Produktbeskrivelse

iBond® Eтч gel og væske er etsmidler baseret på orthophosphorsyre. De anvendes til at ætse emalje og dentin i forbindelse med adhesiv fyldninger.

Sammensætning

iBond® Eтч 20 gel indeholder 20 % fosforsyre. iBond® Eтч 35 gel/væske indeholder 35% fosforsyre.

Produktet indeholder desuden fortykningsmidler, pigmenter, vand

Indikatorer

Emaljeetsning og emalje-/dentinætsning i forbindelse med den totale ætsteknik inden adhesivblanding af:

• Restaureringer af komposit- og komponentmaterialer • Laboratoriefremstillede, indirekte restaureringer (fx inlays, kroner, broer, facader) • Fissurforsøgelser

Kontraindikationer

- Anvendelse i dentin tæt på pulpa (mindre end 1 mm)
- Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for iBond® Eтч

Bivirkninger

Dette produkt eller en af dets komponenter kan i særlige tilfælde forårsage allergiske reaktioner. Hvis der er mistanke herom, kan der rekvireres oplysninger om indholdsstofferne fra fabrikanten.

Interaktioner

Liner- og bunddekningsmaterialer, som fx calciumhydroxid, kan afhængigt af deres type og sammensætning blive opløst af syren.

Advarsler/forholdsregler

iBond® Eтч 20 gel indeholder 20 % fosforsyre og er et irriterende stof. iBond Eтч 35 gel og væske 35 indeholder 35% fosforsyre og kan forårsage kemisk forbrænding. Kan irritere øjne. Undgå kontakt med gingiva, hud, øjne og de tilstødende tænder. I tilfælde af kontakt med mundslimhinden skal der skylles grundigt med rigelige mængder vand. Hvis det indtages, skal munden skylles grundigt mund med vand, og patienten skal derefter drikke rigeligt vand. Søg læge. I tilfælde af hudkontakt vaskes huden grundigt med vand og sæbe. I tilfælde af kontakt med øjnene skal de skylles grundigt med vand, og der skal søges læge. Bør beskyttes/behandskes. Undgå hudkontakt. Bør beskyttes/espå-kledning. Bør beskyttes/biller/ansigtskæm. Bekledning, der er kontamineret med iBond® Eтч 35 gel eller iBond® Eтч 35 væske, skal straks tages af.

iBond® Eтч 20 Gel, iBond® Eтч 35 Gel, iBond® Eтч 35 Fluid

Produktbeskrivelse

iBond® etsegel og etsewæske er etsmidler basert på ortofosfatsyre. De brukes til å etse emalje og kondisjonere dentinet i sammenheng med adhesiv fyllingsterapi.

Sammensetning

iBond® Eтч 20 Gel inneholder 20 % fosforsyre.

iBond® Eтч 35 Gel inneholder 35 % fosforsyre.

Produktene inneholder også tykningsmidler, pigmenter og vann

Indikasjoner

Emaljeetsning og emalje/dentinsetsning i sammenheng med total etsingsteknikk før adhesivblanding av:

• Komposit- og kompeerrestaureringer • Laboratorietilvirkede, indirekte restaureringer (f.eks. inlays, kroner, broer, beleg) • Forsøglingsmateriale

Kontraindikasjoner

• Påføring på dentin nær pulpaen (mindre enn 1 mm) • Skal ikke brukes ved forekomst av kjent hypersensitivitet ovenfor iBond® Eтч

Bivirkninger

Produktet eller en av dets komponenter kan i enkelte tilfeller forårsake allergiske reaksjoner. Ved mistanke om et slikt tilfelle, kan informasjon om innholdsstoffene skaffes fra produsenten.

Interaksjoner

Liner og grunnmateriale, som f. eks. kalsiumhydroksid kan oppløses av syren, avhengig av type og sammensetning.

Advarsler/forholdsregler

iBond® Eтч 20 Gel inneholder 20 % fosforsyre og er et irriterant. iBond Eтч 35 Gel og Fluid 35 inneholder 35% fosforsyre og kan forårsake kjemisk forbrenning. Kan irritere øyne. Undgå kontakt med gingiva, hud, øyne eller naboløst. I tilfelle det oppstår kontakt med oral mukosa, skyl grundig med store mengder vann. Ved sveiging skyl munnen grundig med vann og drikk deretter store mengder vann. Kontakt en lege. I tilfelle det kommer i kontakt med huden, skyl grundig med såpe og vann. I tilfelle det kommer i kontakt med øynene skyl rikelig med vann og rådfør deg med lege hvis nødvendig. Bruk passende vernehansker. Undgå kontakt med huden. Ha på beskyttende klær. Bruk vernehansker/ansiktsvern. Fjern omgående klær som er blitt kontaminerte med iBond® Eтч 35 Gel eller iBond® Eтч 35 Fluid.

iBond® Eтч 20 Gel, iBond® Eтч 35 Gel, iBond® Eтч 35 Fluid

Tuotekuvaus

iBond® Eтч -geeli ja -neste ovat ortofosforihappopohjaisia etsausaineita. Niitä käytetään hammaskiilteen etsaukseen ja hammasluun korjaukseen adhesiivisessa paikkauksessa.

Koostumus

iBond® Eтч 20 -geeli sisältää 20 % fosforihappoa.

iBond® Eтч 35 -geeli/neste sisältää 35 % fosforihappoa.

Lisäksi tuotteet sisältävät sakeutusaineita, väriaineita, vettä.

Indikaatiot

Hammaskiilteen etsaus ja hammaskiilteen/hammasluun etsaus kokonaissuutsaestekniikan yhteydessä ennen seuraavia sidostamistoimia:

• kompositti- ja kompeerirestauroinnit • laboratoriovalmisteiset, epäsuorat restauroinnit (esim. inlay, kruunut, sillat, fassadit) • biivesteaineet.

Kontraindikatiot

• Levittäminen hammasluuhun lähelle hammasydintä (alle 1 mm) • Ei saa käyttää, jos tiedossa on yliherkkyys iBond® Eтч -tuotteille.

Sivuvaikutukset

Tämä tuote tai jokin sen ainesosa voi aiheuttaa tiettyissä tapauksissa allergisia reaktioita. Pyydä tarvittaessa tuotea tuotteen ainesosista valmistajalta.

Interaktiot

Happo voi liuottaa alustäytemateriaalia ja muotulutumateriaalia, esimerkiksi kalsiumhydroksidia, riippuen tyypistä ja koostumuksesta.

Varoitukset/varoitimet

iBond® Eтч 20 -geeli sisältää 20 % fosforihappoa ja aiheuttaa ärsytystä. iBond Eтч 35 -geeli ja -neste 35 sisältävät 35 % fosforihappoa ja voivat aiheuttaa kemiallisia palovammoja. Voi ärsyttää silmiä. Varo koskettamasta ikeniä, ihoa, silmiä tai vieressä hamppia. Jos aineita joutuu suun limakalvoille, huuhtele huolellisesti runsaalla vedellä. Jos aineita nautitaan, suu on huuhdeltava huolellisesti vedellä ja ensin jalkaan on juotava paljon vettä. Ota yhteys lääkäriin. Jos aineita joutuu holtte, huuhtele huolellisesti saippualla ja vedellä. Jos aineita joutuu silmiin, huuhtele huolellisesti vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Käytä sopivia suojakäsineitä. Vältä ihokosketusta. Käytä suoja- vaatteitusta. Käytä suojalasia/suojakasvomaskia. Riisu heti vaatteet, joihin on tippunut iBond® Eтч 35 -geeliä tai iBond® Eтч 35 -nestettä.

iBond® Eтч 20 Gel, iBond® Eтч 35 Gel, iBond® Eтч 35 Fluid

Περιγραφή προϊόντος

Η γέλη και το υγρό iBond® Eтч είναι παράγοντες αδρόσητοι με βάση το ορθοφθορικό οξύ. Χρησιμοποιούνται για την αδρόσηση της αδραμονικής και την προετοιμασία της οδοντικής στα πλαίσια της θεραπείας έμφυρης με συγκολητικής οδού.

Σύνθεση

Η γέλη iBond® Eтч 20 περιέχει 20 % φθορικό οξύ. Η γέλη/το υγρό iBond® Eтч 35 περιέχουν 35 % φθορικό οξύ. Τα προϊόντα περιέχουν επιπλέον πυκνωτικά μέσα, χρωστικά και νερό.

Ενδείξεις

Αδρόσηση αδραμονικής και αδρόσηση αδραμονικής/οδοντικής στα πλαίσια της τεχνικής ολικής αδρόσησης πριν τη συγκόλληση:

• Αποκατάσταση σύνθετων υλικών και συμπυκνωμα • Έμμεσων αποκαταστάσεων εργαστηριακής κατασκευής (π.χ. ένθετα, στεφάνες, γέφυρες, όψεις) • Υλικών έμφυρης αδρόσησης

Αντενδείξεις

• Εφαρμογή στην οδοντική κοντά στον πολφό (λιγότερο από 1 mm) • Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής υπερευαίσθησίας στο iBond® Eтч.

Παρενέργειες

Αυτό το προϊόν ή ένα από τα συστατικά του μπορούν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Σε υποψία αλλεργικής αντίδρασης, πληροφορίες για τα συστατικά μπορούν να ληφθούν από τον κατασκευαστή.

Άλληλενδείξεις

Υλικά ουδέτερου στρώματος, όπως το υδροξείδιο του οξείσου, είναι δυνατό να διαλυθούν από το οξύ, ανάλογα με τον τύπο και τη σύνθεσή τους.

Προειδοποιήσεις/Προφυλάξεις

Η γέλη iBond® Eтч 20 περιέχει 20 % φθορικό οξύ και είναι ερεθιστική. Η γέλη iBond Eтч 35 και το υγρό 35 περιέχουν 35 % φθορικό οξύ και μπορούν να προκαλέσουν ηχηρά εγκαύματα. Μπορεί να προκληθεί ερεθισμός στα μάτια. Να αποφεύγετε τη επαφή με το αυτί, το δέρμα, τα μάτια ή τα γεννητικά όργανα. Σε περίπτωση επαφής με τον σταματικό βλεφάρων, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε καλά το στόμα με νερό και πιπιλήστε πιεστή άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε καλά με σαπουνί και νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με νερό και συμβουλευτείτε έναν ιατρό. Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. Να αποφεύγετε η επαφή με το δέρμα. Φοράτε προστατευτικό ματσοπέ. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας/προστατευτικό πρόσωπο. Αφαιρέστε αμέσως τυχόν ενδύματα που έχουν λερωθεί με γέλη iBond® Eтч 35 ή υγρό iBond® Eтч 35.

iBond® Eтч 20 Gel, iBond® Eтч 35 Gel, iBond® Eтч 35 Fluid

Popis výrobku

Gel a tekutina iBond® Eтч jsou leptací činidla založená na kyselíně orthofosforečné. Používají se k leptání skloviny a úpravě dentinu v kontextu adhezivní terapie.

Složení

Gel iBond® Eтч 20 obsahuje 20 % kyseliny fosforečné.

Gel/tekutina iBond® Eтч 35 obsahuje 35 % kyseliny fosforečné.

Přípravky dále obsahují zahusťovadla, pigmenty a vodu.

Indikace

Leptání skloviny a leptání skloviny/dentinu v kontextu techniky totálního leptání před adhezivní vazbou:

• kompozitních a komponentních výplní, • laboratorně připravených nepřímých výplní (např. inlaye, korunky, můstky, fazety) • pečetění fisur.

Kontraindikace

• Aplikace na dentin v blízkosti dřeně (méně než 1 mm). • Nepoužívejte v případě známé precitlivlosti na iBond® Eтч.

Nežádoucí účinky

Tento přípravek nebo některá z jeho složek může ve zvláštních případech způsobovat alergické reakce. V případě podezření lze získat informace o složkách od výrobce.

Interakce

Některé podložkové materiály, například hydroxid vápenatý, mohou být rozpuštěny kyselinou v závislosti na jejich typu a složení.

Varování/bezpečnostní opatření

Gel iBond® Eтч 20 obsahuje 20 % kyseliny fosforečné a má dráždivé účinky. Gel iBond Eтч 35 a tekutina 35 obsahují 35 % kyseliny fosforečné a mohou způsobovat popelání. Může dráždit oči. Chraňte před stykem s gingivou, kůží, očima nebo sousedními zuby. V případě kontaktu s ústní sliznicí důkladně vypláchněte velkým množstvím vody. V případě rozlití důkladně vypláchněte ústa vodou a poté zaplňte velkým množstvím vody. Obratle se na lékaře. V případě kontaktu s kůží důkladně opláchněte mírně vodou. V případě vniknutí do očí propláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice. Zabraňte styku s kůží. Používejte ochranné oděvy. Používejte ochranné brýle / ochranu obličje. Ihned odstraňte oděv poříšněným gelem iBond® Eтч 35 nebo tekutinou iBond® Eтч 35.

iBond® Eтч 20 Gel, iBond® Eтч 35 Gel, iBond® Eтч 35 Fluid

Termékszemlélet

Az iBond® Eтч gél és folyadék ortofoszforsav alapú savazószeranyagok. A zománc savazására és a dentin kondicionálására szolgálának adhezív tömés során.

Összetétel

Az iBond® Eтч 20 gél 20 % foszforsavat tartalmaz.

Az iBond® Eтч 35 gél/folyadék 35 % foszforsavat tartalmaz.

A termék további összetevői: sűrítőszeranyagok, pigmentek, víz

Javallatok

A zománc savazására és a zománc/dentin „total etching” technikával történő savazására az alábbi restaurációk bonyolonyag történő felragasztása előtt:

• Kompozit és komponer restaurációk (például inlay-ek, koronák, hidak, hídjak) • Barázódásos anyagok

Ellenjavallatok

• Ha az anyagot a dentinre kell felvinni, a pulpához közel (kevésbé, mint 1 mm-re) • Az iBond® Eтч anyaggal szemben fennálló ismert túlérzékenység esetén nem alkalmazható

Mellékhatások

A termék vagy egyes összetevői bizonyos esetekben allergiás reakciókat okozhatnak. Ha fennáll ennek gyanúja, az összetevőkre vonatkozó információkat a gyártó kérésre rendelkezésre bocsátja.

Interakciók

Az átlátszó bélelé és alapozó anyagokat, például a kalcium-hidroxidot, az anyag típusától és összetételétől függően oldhatja a sav.

Figyelmeztetések/óvintézkedések

Az iBond® Eтч 20 gél 20 % foszforsavat tartalmazó, irritáló anyag. Az iBond Eтч 35 gél és folyadék 35 % foszforsavat tartalmaz, és kémiai égéseket okozhat. Irritálhatja a szemet. Ne kerüljön a fognyerve, a bőre, a szembe vagy a szomszédos fogakra. Ha a szembe kerül, vízzel öblögetni kell, bő vízzel alaposan öblítse le. Lenyelése esetén alaposan öblítse ki a szájat vízzel, majd igyon bőséges mennyiségű vizet. Forduljon orvoshoz. Ha a szem a bőre kerül, szaggannal és vízzel alaposan öblítse le. Ha a szembe kerül, bő vízzel mossa ki, és forduljon orvoshoz. Viseljen megfelelő védőkesztyűt. Forduljon orvoshoz. A szem bőre ne kerüljön. Viseljen védőruházatot. Viseljen védőszemüveget/arcvédőt. Az iBond® Eтч 35 géllal vagy iBond® Eтч 35 folyadékkal szennyezett ruházatot azonnal le kell venni.

iBond® Eтч 20 Gel, iBond® Eтч 35 Gel, iBond® Eтч 35 Fluid

Izstrādājuma apraksts

iBond® Eтч gēls un šķidrums ir kodināšanas līdzekļi uz ortofosforskābes bāzes. Tos izmanto emaljas kodināšanai un dentīna kondicionēšanai, ja paredzēts lietot adhezīvu pielasnes terapiju.

Sastāvs

iBond® Eтч 20 gēls satur 20 % fosforskābi. iBond® Eтч 35 gēls/šķidrums satur 35 % fosforskābi. Izstrādājumi satur arī sabiezinātājus, pigmentus un ūdeni.

Indikācijas

Emaljas un emaljas/dentīna kodināšana, izmantojot pilnīgu kodināšanas tehniku pirms adhezīva piesaistes:

- kompozitmateriālu un kompomeru restaurācijām;
- laboratorijā izgatavotām netiešām restaurācijām (piemēram, inlejam, kroņiem, tiltiem, venīriem);
- silantēm.

Kontraindikācijas

• izmantojot dentīnam pulpas tuvumā (tuvāk par 1 mm) • nelietot zināma paaugstināta jutīguma gadījumā pret iBond® Eтч.

Blakusparādības

Dažos gadījumos šīs izstrādājums vai kāda no tā sastāvdaļām var izraisīt alerģiskas reakcijas. Ja radušās aizdomas, informāciju par sastāvdaļām var saņemt no ražotāja.

Mijiedarbība

Oderēšanas un pamata veidošanas materiāli atkarībā no to veida un sastāva, piemēram, kalcija hidroksids, var izšķīst skābes iedarbībā.

Bridinājumi/piesārņozības pasākumi

iBond® Eтч 20 gēls satur 20 % fosforskābi, un tam ir kairinoša iedarbība. iBond Eтч 35 gēls un šķidrums 35 satur 35 % fosforskābi, un var radīt ķīmiskus apdegumus. Var kairināt acis. Nepieļaujiet materiāla saskari ar smaganām, ādu, blakus esošajiem zobiem vai iekļūšanu ausī. Saskaņos gadījumā ar mutes gļotādu, rūpīgi skalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Ja norīt, rūpīgi izskalojiet muti ar ūdeni un pēc tam dzeriet daudz ūdens. Konsultējieties ar ārstu. Saskaņos gadījumā ar ādu rūpīgi noskalojiet ar ūdeni un pēc tam dzeriet daudz ūdens. Ja materiāls iekļūst ausī, rūpīgi skalojiet ar ūdeni un vēsieties pēc medicīniskās palīdzības. Vairākus piemērotus aizsargmērkus. Nepieļaujiet saskarsmi ar ādu. Valkājiet aizsargapģēbu. Valkājiet aizsargbrilles /sejās aizsargmasku. Nekavējoties novietiet apģēbu, kas piesārņots ar iBond® Eтч 35 gēlu vai iBond® Eтч 35 šķidrumu.

iBond® Eтч 20 Gel, iBond® Eтч 35 Gel, iBond® Eтч 35 Fluid

Produkto aprašymas

„iBond® Eтч Gel” ir „Fluid” yra esdinančios medžiagos, kurių pagrindą sudaro ortofosforo rūgštis. Jos naudojamos emaliui esdinti ir dentinui kondicionuoti prieš adhezinį plombavimą.

Sudėtis

„iBond® Eтч 20 Gel” sudėtyje yra 20 % fosforo rūgštis. „iBond® Eтч 35 Gel”/„Fluid” sudėtyje yra 35% fosforo rūgštis.

Preparatuose dar yra trishianidų medžiagų, pigmentų, vandens.

Indikacijos

Emalės esdinimas ir etnatis (dentin) esdinimas, kartu taikant bendrąjį esdinimo metodiką prieš adhezinį sukibimą:

- kompozicinis medžiagos ir kompomero restauracijos;
- laboratorijoje pagamintų, netiesioginių restauracijų (pvz., įliotų, karinėlių, tiltų, venyrų);
- silantų.

Kontraindikacijos

• Naudooti dentinui netoli pulpos (mažiau kaip 1 mm atstumu) • Nenaudokite, jei žinote, kad yra padidėjęs jautrumas „iBond® Eтч” medžiagai

Pašalinis poveikis

Šis preparatas arba kuri nors iš jo sudėtinųjų dalių tam tikrais atvejais gali sukelti alergines reakcijas. Įtarus tai, informaciją apie sudėtinės medžiagas galima gauti iš gamintojo.

Perspaūėjimai ir atsargumo priemonės

„iBond® Eтч 20 Gel” sudėtyje yra 20 % fosforo rūgštis, jis dirgina. „iBond Eтч 35 gel” ir „Fluid 35” sudėtyje yra 35% fosforo rūgštis, jis gali sukelti chemiškis nudegimus. Gali dirginti acis. Saugokite, kad nepatektų ant dantenų, odos, į akis ar ant gretai esančių dantų. Po susilietimo su burnos gleivine kruopščiai išplaukite dideli kiekiu vandens. Nurijus, rūpiai išskalojite burną vandeniu ir po to gerkite daug vandens. Kreipkitės į gydytoją. Patekus ant odos, kruopščiai nuplaukite, naudodami muilą ir vandenį. Patekus į akis, kruopščiai išplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Mūvėkite tinkamas apsaugines prietaisus. Venkite patekimo ant odos. Dėvėkite apsauginius drabužius. Dėvėkite apsauginius akinius arba veido apsaugą. Nedelsdami nusivirkite rūbus, kurie buvo užteršti „iBond® Eтч 35 Gel” arba „iBond® Eтч 35 Fluid”.

iBond® Eтч 20 Gel, iBond® Eтч 35 Gel, iBond® Eтч 35 Fluid

Opis produktu

iBond® Eтч gel i postaci želu i fluidu to czynniki wytrawiające na bazie kwasu ortofosforowego. Są one stosowane do wytrawiania szkliwa i kondycjonowania zębów przy wypełnianiach w technice adhezyjnej.

Skład

iBond® Eтч 20 żel zawiera kwas fosforowy 20 %. iBond® Eтч 35 żel/fluid zawiera kwas fosforowy 35 %. Ponadto produkty zawierają środki zagęszczające, pigmenty i wodę.

Wskazania

Wytrawianie szkliwa i wytrawianie szkliwa/zębiny przy stosowaniu techniki total etch przed adhezyjnym wiazaniem:

• Odbudowy z materiałów kompozytowych i kompomero • Odbudowy protetyczne wykonane metodą pośrednią (np. wkłady koronowe, korony, mosty, licówki) • Uszczelniające-laki

Przeciwwskazania

• Stosowanie na zębnie w pobliżu miazgi (odległość mniejsza niż 1 mm) • Nie używać w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na iBond® Eтч

W szczególnych przypadkach produkt lub jeden z jego komponentów może wywołać reakcję alergiczne. W razie podejrzenia takich reakcji, producent udzieli informacji na temat składu produktu.

Interakcje

Podścielające i materiały podkładowe, takie jak wodorotlenek sodu, mogą ulec rozpuszczeniu pod wpływem kwasu, w zależności od ich rodzaju i składu.

Ostrzeżenia/środki ostrożności

iBond® Eтч 20 żel zawiera kwas fosforowy 20 % i jest środkiem drażniącym. iBond® Eтч 35 żel/fluid zawiera kwas fosforowy 35 % i może spowodować poparzenia chemiczne. Może wywołać podrażnienie oczu. Unikaj kontaktu z dziąsłami, skórą, oczami i sskładającymi zębami. W razie kontaktu z błoną śluzową jamy ustnej, przemyć dużą ilością wody. W przypadku pokłknięcia, starannie przemyć usta wodą i wypij dużą ilość wody. Konsultować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą, starannie przemyć wodą. W razie przedostania się produktu do oczu, starannie przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Unikaj kontaktu ze skórą. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Nosić okulary ochronne/maseczkę na twarz (zrybnicze). Natychmiast zdjąć odzież w przypadku jej zabrudzenia zelem iBond® Eтч 35 lub fluidem iBond® Eтч 35.

Anvendelse

Inden behandlingen startes, skal tanden forsigtigt pudses med fluorfri poleringspasta.

Det tilrådes at bruge kofferdam.

1. Efter præparation skylles kaviteten i/efter adhevis fyldningsprincipper og tørres med olefri luft.

2. Start fra de facetterede emaljeområder og applicer iBond® Eтч på hele kavitetens overflade, også dentinen. Sørg for at ætse em